

铜箔厚度测量仪 铜箔测厚仪 硅片厚度测量仪

产品名称	铜箔厚度测量仪 铜箔测厚仪 硅片厚度测量仪
公司名称	济南三泉中石实验仪器有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:三泉中石 型号:CHY-U 产地:山东济南
公司地址	山东省济南市市中区阳光新路绿地泉景雅园商务大厦1635室（注册地址）
联系电话	0531-67813036 15665715386

产品详情

铜箔厚度测量仪 铜箔测厚仪 硅片厚度测量仪

铜箔、硅片、箔片、铝箔、金属箔片等材料在电子、电力、建筑、汽车等领域有着广泛的应用。这些材料都具有特定的厚度和精度要求，因此厚度测量是这些材料生产和加工过程中必不可少的一个环节。机械接触式厚度测量仪器是一种常见的厚度测量仪器，通过接触式测量方法，可以准确地测量各种材料的厚度。

铜箔、硅片、箔片、铝箔、金属箔片等材料在厚度方面具有不同的特点。铜箔具有较高的导电性和耐腐蚀性，常用于制造电子线路和电器元件。硅片则是一种半导体材料，常用于制造集成电路和太阳能电池。箔片具有轻便、美观和防潮等特点，常用于包装和装饰领域。铝箔则具有轻便、防水和耐腐蚀等特点，常用于食品包装和建筑领域。金属箔片具有高强度和延展性等特点，常用于制造金属制品和汽车零部件。

针对这些不同材料的厚度测量，机械接触式厚度测量仪器可以采用不同的测量头和传感器进行测量。对于铜箔和硅片，可以采用金刚石或碳化硅等高硬度材料制成的测量头和传感器，以避免对被测材料造成划伤或损坏。对于箔片和铝箔，可以采用柔性测量头和传感器，以避免对被测材料造成形变或破坏。

在铝箔的厚度测量中，机械接触式厚度测量仪器可以选用专用的铝箔测量头和传感器进行测量。这种测

量头采用特殊设计，可以避免对铝箔造成划伤或损坏，同时提高测量的精度和稳定性。此外，还可以选用数字式数据采集器，以便更准确地显示铝箔的厚度。

一种可靠的厚度测量仪器，适用于铜箔、硅片、箔片、铝箔、金属箔片等材料的厚度测量。针对不同材料的特性和应用领域，可以选择不同的测量头和传感器进行测量，以确保测量的精度和稳定性。同时，仪器的维护和保养也是保证其长期使用的重要环节。随着科技的不断发展，机械接触式厚度测量仪器在不断地更新换代，测量精度和稳定性也不断提高。

技术参数

测量范围	0-2mm（其他量程可定制）
分辨率	0.1um
测量速度	10次/min（可调）
测量压力	17.5 ± 1kPa（薄膜）；100 ± 1kPa（纸张）
接触面积	50mm（薄膜），200mm（纸张）注：薄膜、纸张任选一种
进样步距	0 ~ 1300 mm(可调)
进样速度	0 ~ 120 mm/s(可调)
机器尺寸	450mm × 340mm × 390mm (长宽高)
重量	23Kg
工作温度	15 -50
相对湿度	80%,无凝露
试验环境	无震动，无电磁干扰
工作电源	220V 50Hz

铜箔厚度测量仪 铜箔测厚仪 硅片厚度测量仪

此为广告